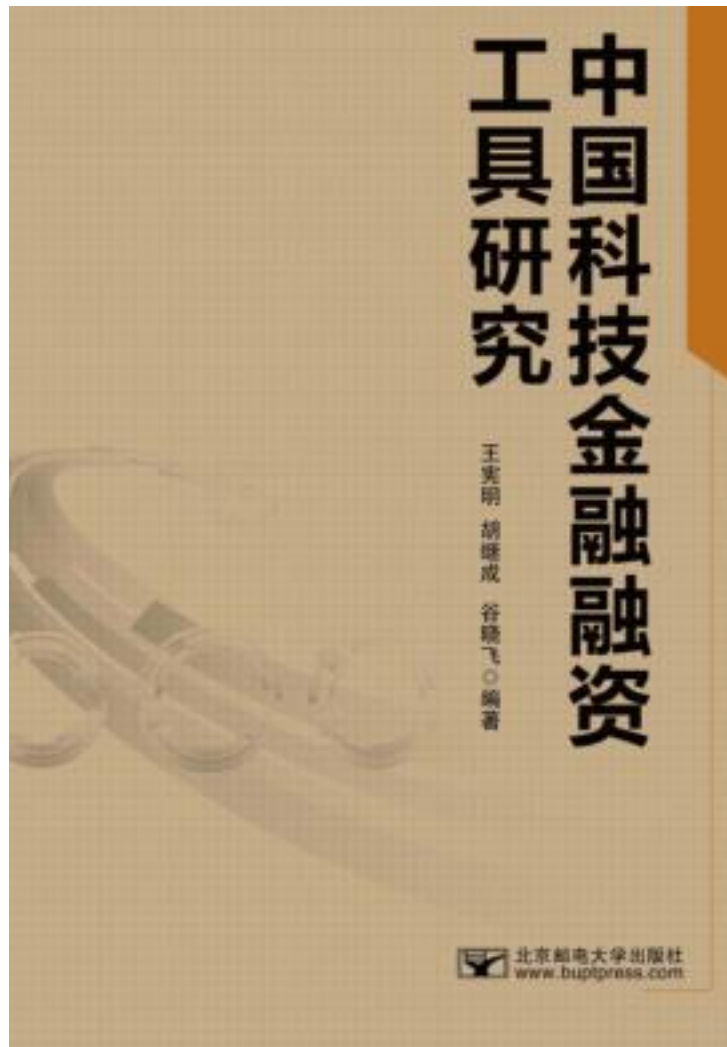


中国科技金融融资工具研究



作者：王宪明，胡继成，谷晓飞编著

出版社：北京：北京邮电大学出版社

出版日期：2014.01

总页数：209

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/96080742.html>）查找全本阅读方式

中国科技金融融资工具研究 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/96080742.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/96080742.html>

书名：中国科技金融融资工具研究